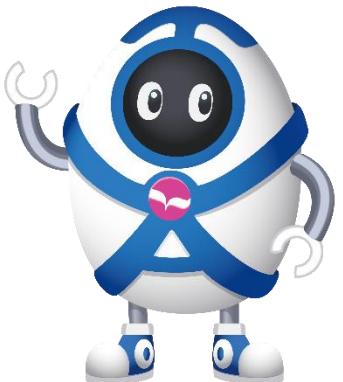


2026年3月期

第3四半期決算説明資料

2026年2月6日

[Click here for the English Ver](#)



1. 2026年3月期 第3四半期実績
2. 2026年3月期 通期予想

1. 2026年3月期 第3四半期実績
2. 2026年3月期 通期予想

2026年3月期 第3四半期サマリー

受注高
446.5 億円
(前年同期比 +20.1%)

売上高
369.3 億円
(前年同期比 ▲5.9%)

営業利益
36.8 億円
(前年同期比 ▲43.5%)

経常利益
36.9 億円
(前年同期比 ▲47.8%)

当期純利益
26.2 億円
(前年同期比 ▲49.0%)

受注高

- メモリや先端パッケージ向けなどAI・データセンタ向けを中心に受注は好調。
- 第3四半期の受注高は196.2億円となり、四半期ベースでは過去2番目の高水準を記録。

売上高

- 1Qでの米国関税の影響や車載用半導体向け投資低迷などにより、前年同期比で減収。
- 顧客稼働率の改善により、TSS（トータル・ソリューション・サービス）の売上高は増加。

利益

- 売上高の減少に加え、製品ミックス変動や初回納入に伴う追加コストの影響により減益。

2026年3月期 第3四半期連結業績結果

(単位:億円)

	25/3期 3Q累計実績	26/3期 3Q累計実績	増減額	前年比
売 上 高	392.5	369.3	▲ 23.2	▲ 5.9%
営 業 利 益	65.2	36.8	▲ 28.3	▲ 43.5%
営 業 利 益 率	16.6%	10.0%	—	▲ 6.6pt
経 常 利 益	70.8	36.9	▲ 33.8	▲ 47.8%
当 期 純 利 益	51.5	26.2	▲ 25.2	▲ 49.0%

※当期純利益 = 親会社株主に帰属する当期純利益

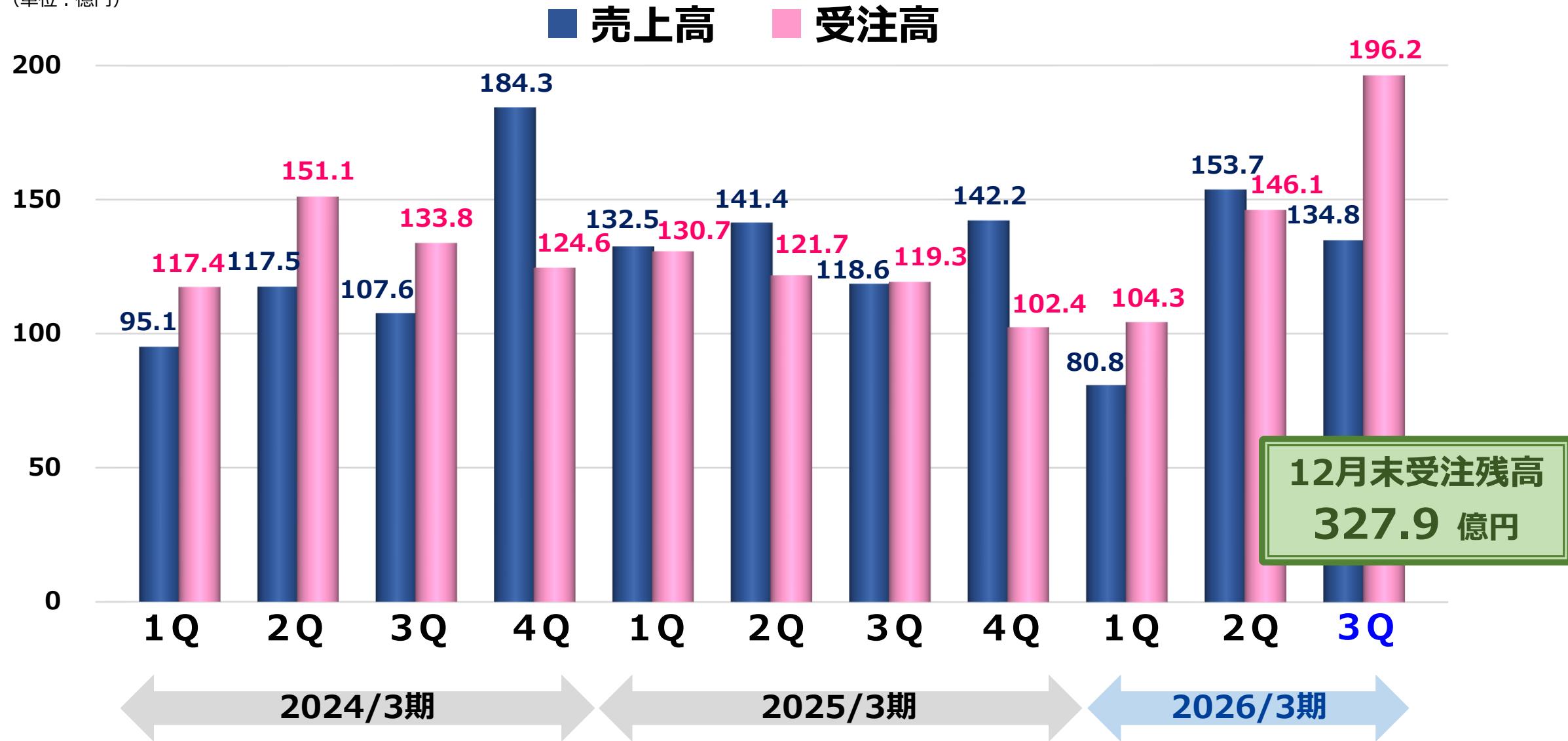
2026年3月期 第3四半期セグメント別売上高

(単位:億円)

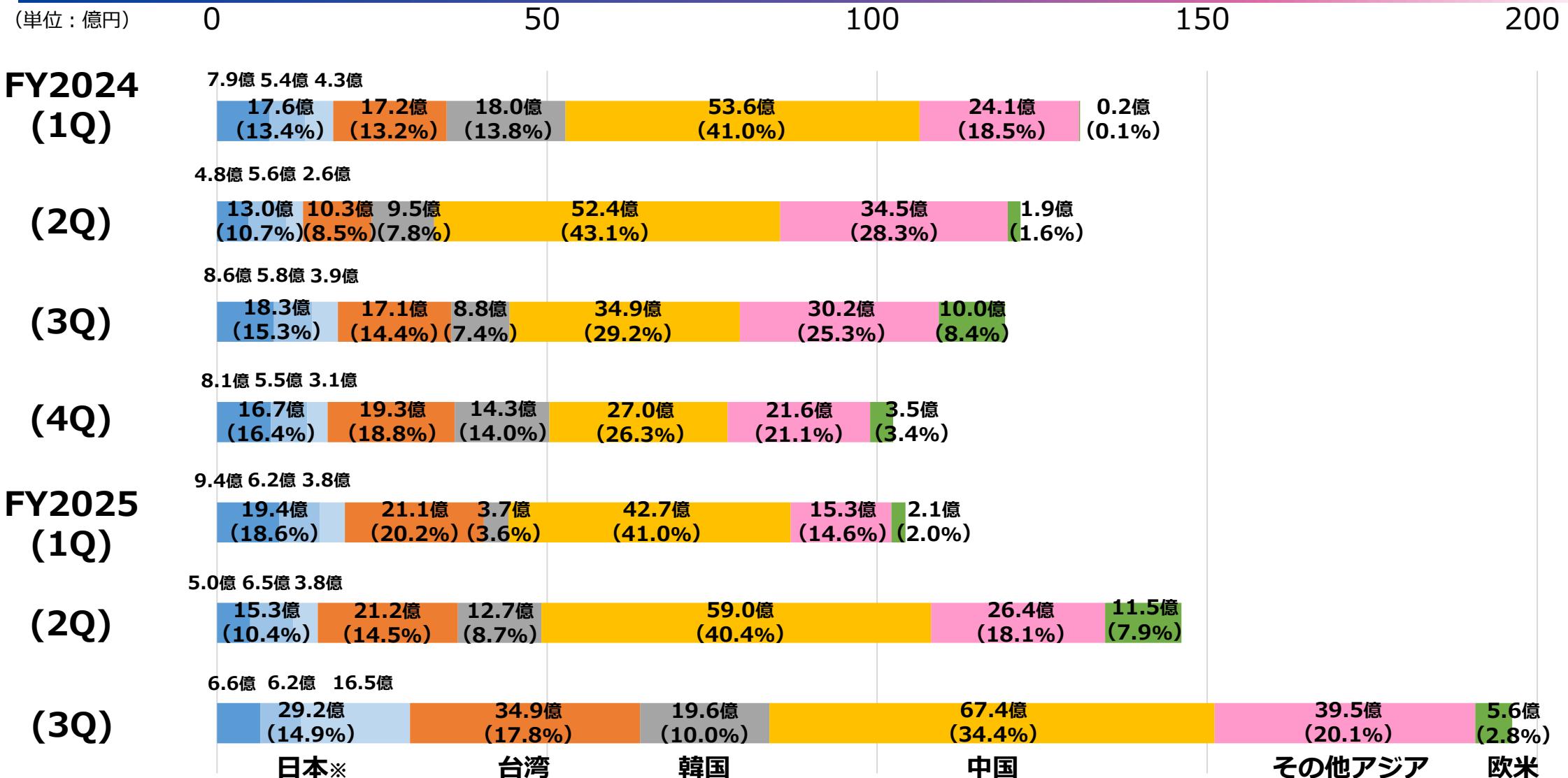
	25/3期 3Q累計実績	26/3期 3Q累計実績	増減額	前年比
売 上 高	392.5	369.3	▲ 23.2	▲ 5.9%
半導体事業	292.7	268.1	▲ 24.6	▲ 8.4%
メディカル デバイス事業	17.3	18.6	+ 1.3	+ 7.8%
新事業	68.4	71.3	+ 2.8	+ 4.1%
レーザ事業	14.1	11.2	▲ 2.8	▲ 20.0%

受注・売上高の推移

(単位: 億円)

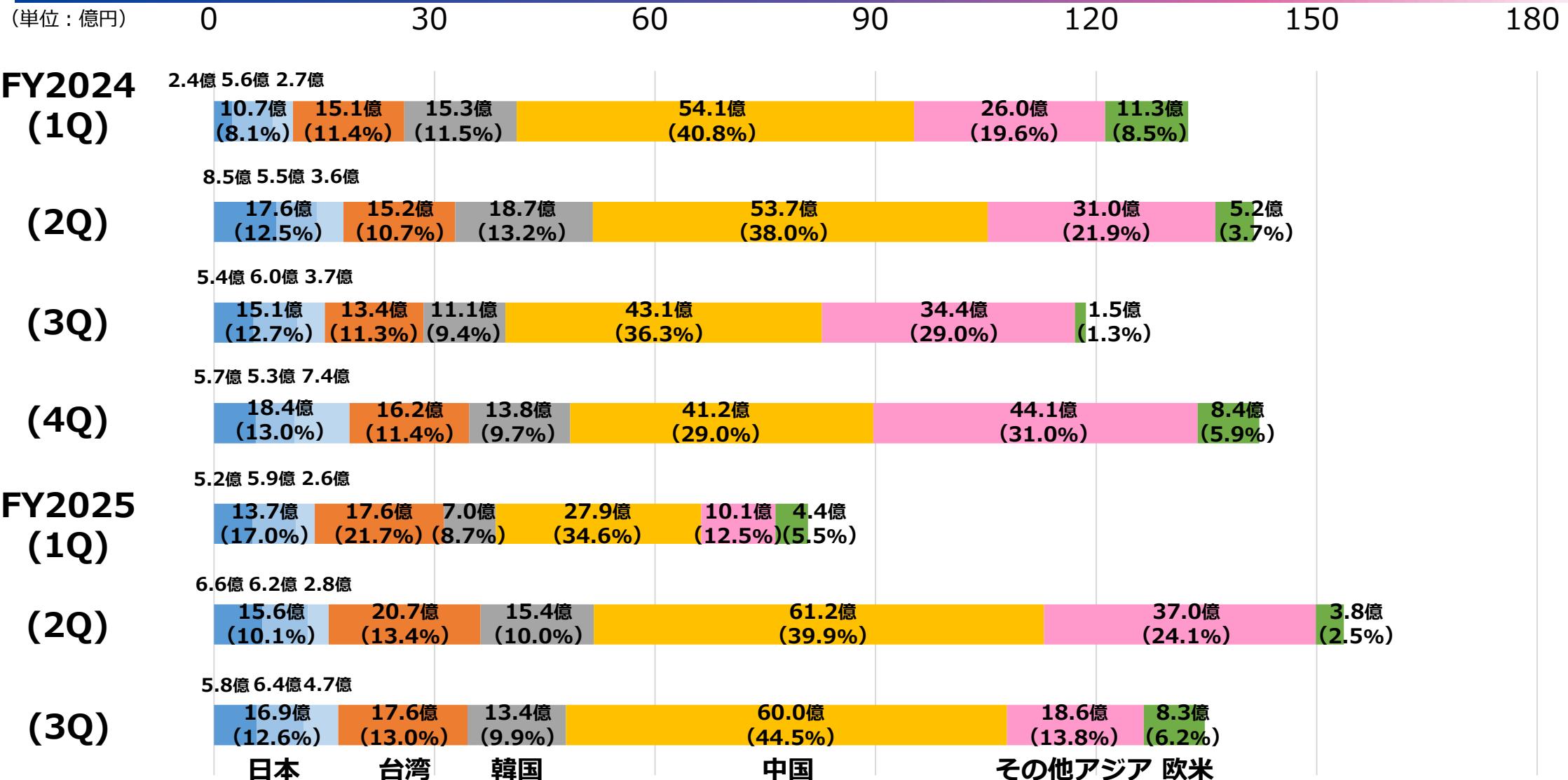


地域別受注構成比率推移（仕向地ベース）



※日本は左から半導体事業（新事業含む）、メディカルデバイス事業、レーザ事業

地域別売上構成比率推移（仕向地ベース）



※日本は左から半導体事業（新事業含む）、メディカルデバイス事業、レーザ事業

2026年3月期3Q 連結営業利益 増減要因分析（対前年同期比）

(単位：百万円)

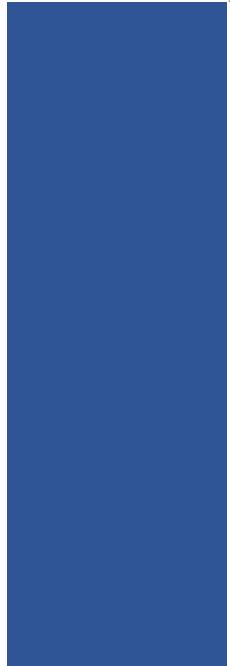
売上 39,259

売上総利益への影響額 △2,512

売上 36,930

6,521

△1,084



売上高の減少
による影響額

△934

製品ミックスなど
による影響額

△494

製造原価に含まれる
開発費などの増加
による影響額

△324

販売管理費の増加
による影響額

3,685



‘25/3期3Q累計 ←

営業利益(2,836百万円減)

→ ‘26/3期3Q累計

※百万円未満切り捨て

1. 2026年3月期 第3四半期実績
2. 2026年3月期 通期予想

通期予想修正について

(単位：億円)

	26/3期 当初予想	26/3期 修正予想	当初予想比
売 上 高	560.0	545.0	▲ 15.0 (▲ 2.7%)
営 業 利 益	98.0	70.0	▲ 28.0 (▲ 28.6%)
営業利益率	17.5%	12.8%	▲ 4.7 pt
経 常 利 益	98.0	70.0	▲ 28.0 (▲ 28.6%)
当期純利益	68.6	49.5	▲ 19.1 (▲ 27.8%)

※当期純利益 = 親会社株主に帰属する当期純利益

修正背景

売上

- メモリの量産投資が想定より後ろ倒し。
- リードタイムの長い評価設備の受注比率が増加。

利益

- トランスマルチ装置における顧客ミックスの変化により、利益率が悪化。
- コンプレッション装置における評価設備やお客様の初号機投資が多く、利益率が一時的に悪化。

2026年3月期 通期 連結業績予想

(単位: 億円)

	25/3期 通期実績	26/3期 予想			増減額	前期比
		3Q累計実績	4Q予想	通期		
売 上 高	534.7	369.3	175.7	545.0	+ 10.2	+ 1.9%
営 業 利 益	88.8	36.8	33.2	70.0	▲ 18.8	▲ 21.2%
営 業 利 益 率	16.6%	10.0%	18.9%	12.8%	▲ 3.8pt	-
経 常 利 益	94.0	36.9	33.1	70.0	▲ 24.0	▲ 25.5%
当 期 純 利 益	81.2	26.2	23.2	49.5	▲ 31.7	▲ 39.0%

※当期純利益 = 親会社株主に帰属する当期純利益

2026年3月期 セグメント別売上予想

(単位: 億円)

変更あり

	25/3期 通期実績	26/3期 予想			増減額	前期比
		3Q累計実績	4Q予想	通期		
売上高	534.7	369.3	175.7	545.0	+ 10.2	+ 1.9%
半導体事業	395.3	268.1	131.7	399.8	+ 4.5	+ 1.1%
メディカル デバイス事業	22.6	18.6	6.4	25.0	+ 2.4	+ 10.7%
新事業	94.2	71.3	28.9	100.2	+ 5.9	+ 6.3%
レーザ事業	22.6	11.2	8.8	20.0	▲ 2.6	▲ 11.4%

今後の市場見通し

受注

- ▶ AI関連投資やメモリ不足により、コンプレッション装置の受注が堅調。
- ▶ 3Qのコンプレッション受注高は四半期ベースで過去最高を記録。
- ▶ 4Q以降も台湾・中国地域を中心にメモリや先端パッケージ向け投資が牽引。

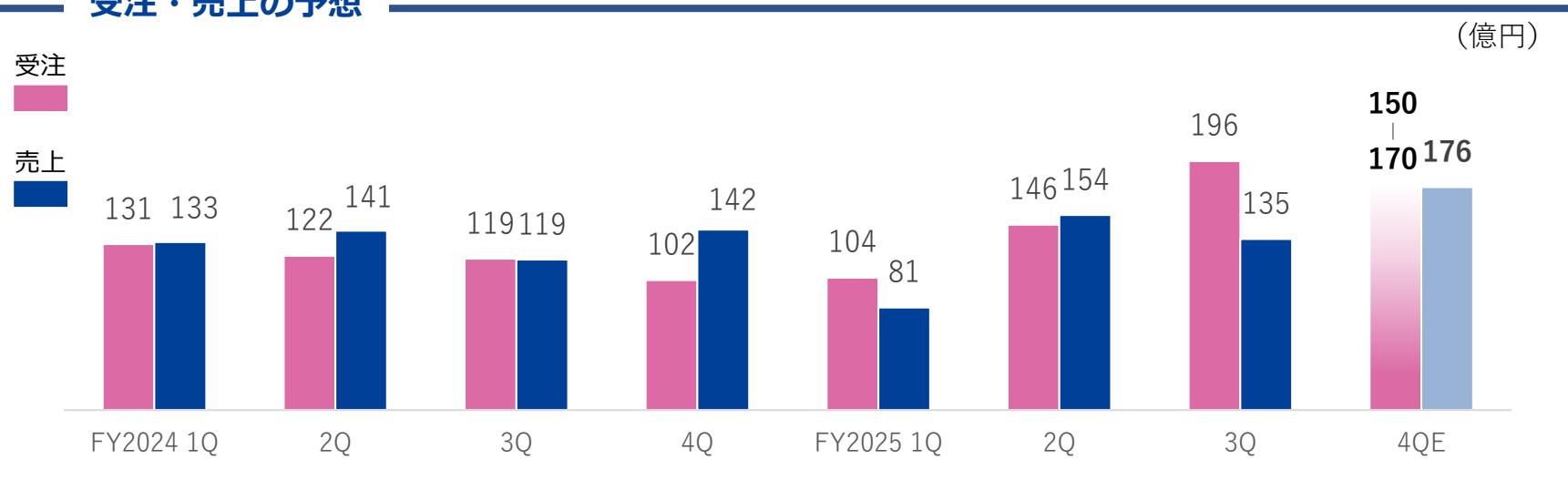
売上

- ▶ 量産受注増加を背景に売上高も今後増加していく見込み。

利益

- ▶ コンプレッション装置の受注高増加に伴い、利益率も徐々に改善を予想。

受注・売上の予想



受注高予想

4Q
150-170億円

損益予想

(2026.02.06 修正)

売上高	545.0億円
営業利益	70.0億円
経常利益	70.0億円
当期利益	49.5億円

TOWAビジョン2032

「変革で世界の頂へ」



《本資料に関するお問合せ》TOWA株式会社 企画部

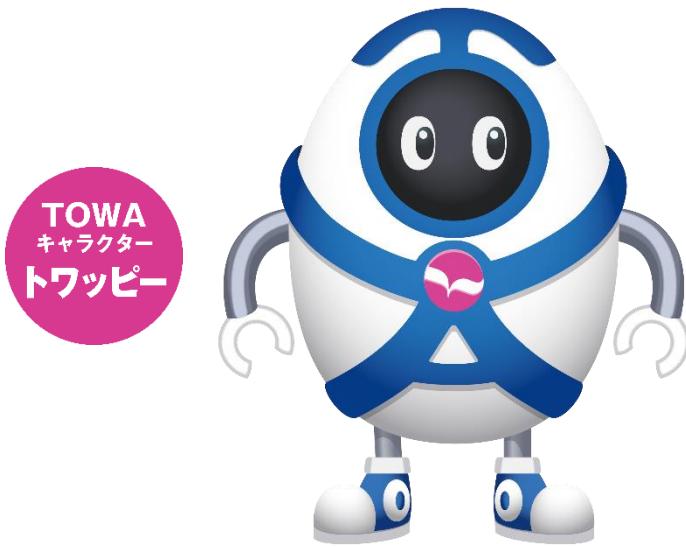
〒601-8105 京都市南区上鳥羽上調子町5番地 Tel : 075-692-0251

本資料には当社グループの計画や方針、財務、技術、製品、サービス、業績等に係る将来予想に関する記述が含まれております。将来予想に関する記述は、あくまで当社グループが現時点において入手可能なデータや仮定、方法等に基づき、当社グループが判断したものであり、様々なリスクや不確定な要因を含んでおります。また、新たなリスクや不確定要因は隨時生じるものであり、その発生や影響を予測することは不可能であります。したがいまして、本資料に含まれる将来に関する記述は、実際の結果とは大きく異なる可能性があることをあらかじめご了承願います。

參考資料



会社概要



トワッピーのプロフィール

- ① 名前：「トワッピー」
- ② 名前の由来：
TOWAから世界にハッピーを届ける。
- ③ 好きな言葉：「チャレンジ！」

会社名	TOWA株式会社
事業内容	半導体事業、メディカルデバイス事業、新事業、レーザ加工装置事業
所在地	京都市南区上鳥羽上調子町 5 番地
設立	1979年 4月
代表取締役会長	岡田 博和
取締役社長執行役員	三浦 宗男
従業員数	2,209名 (2025年12月末時点/連結)
資本金	89億円
証券コード	6315

事業内容

新事業

- ・TSS
(トータルソリューションサービス)
- ・精密加工用工具、受託加工
- ・微細加工
- ・コーティング



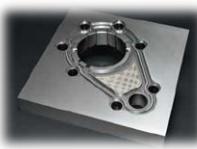
改造・修理
予防保全



微細加工技術



工具（エンドミル）



受託加工

レーザ加工装置事業

- ・レーザトリマ
- ・ウェハーマーカ
- ・レーザ溶接機



レーザトリミング装置
Model SL432R



ウェハーマーキング装置
Model SL473GS3

メディカルデバイス事業

- ・ファインプラスチック成形品
- ・医療機器

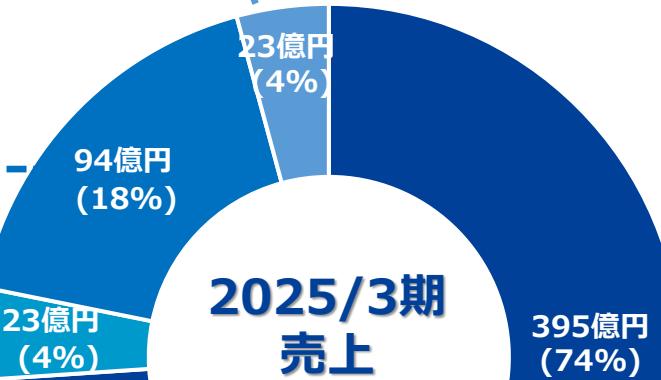


点滴用部品



注射器用部品

2025/3期
売上
534億円



半導体事業

- ・半導体製造用精密金型
- ・半導体製造用モールディング装置
- ・半導体製造用シンギュレーション装置



トランスマルチ金型



モールディング装置
Model PMC2030-D



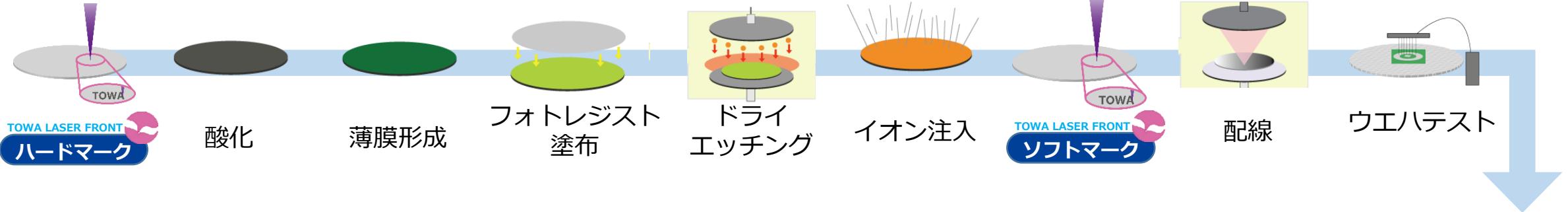
コンプレッション金型



モールディング装置
Model CPM1080

半導体が出来るまで

前工程



製品検査や
信頼性試験を
経て・・・

**半導体
完成！**

TOWA

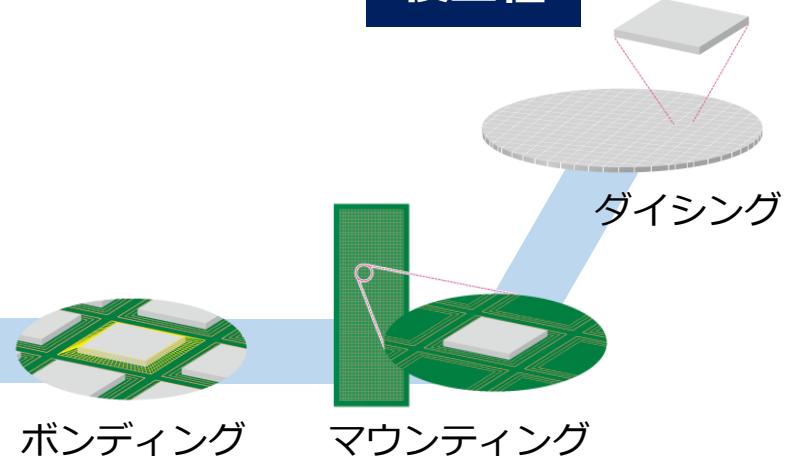
シンギュレーション

モールディング

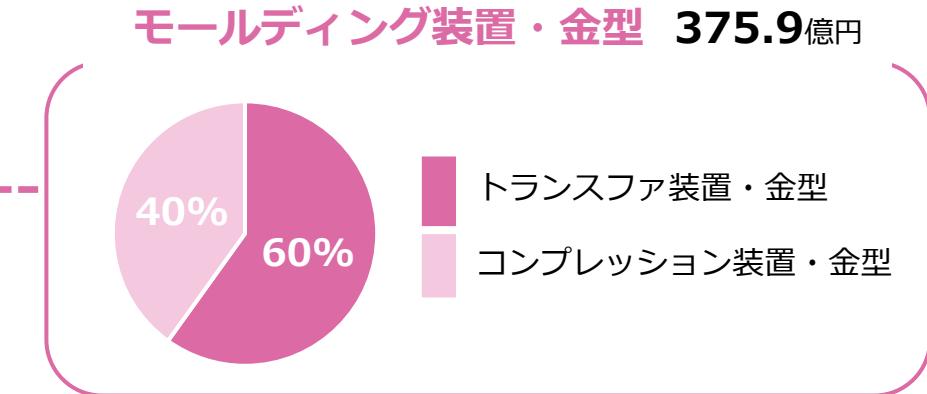
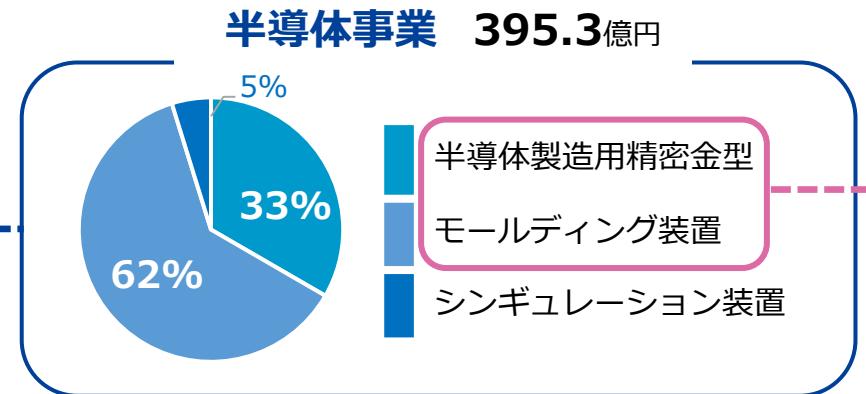
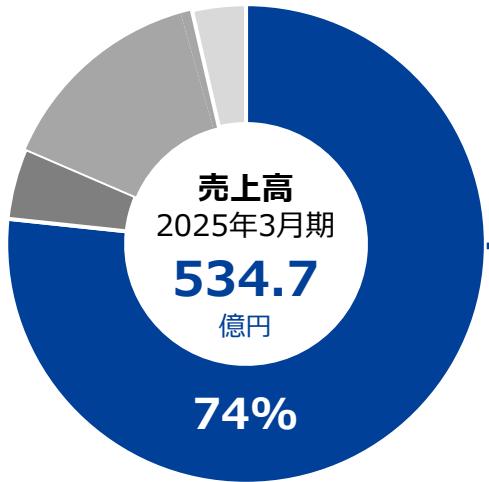
フレームから個々の製品を
切り離します。

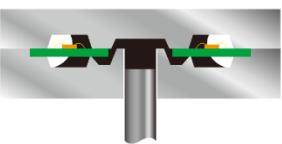
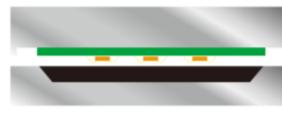
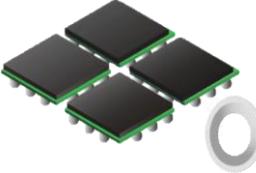
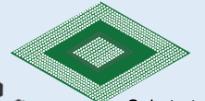
チップを樹脂で封止します。

後工程



半導体事業



モールディング			シンギュレーション		
トランスファ成形		コンプレッション成形			
ポット内で溶融した樹脂を キャビティに充填し 硬化させる成形手法		金型に直接樹脂を入れ、 溶融した後にワークを 浸し入れる成形手法		樹脂で封止された製品を 個片化・収納する工程	
	Lead Frame Exposed package Power Module	 MAP BGA/QFN/ HS BGA		Thicker package Small package	
トランスファ装置	Work size (Max.): 100×300mm	コンプレッション装置	Work size (Max.): 660 × 620mm	シンギュレーション装置	Package size (Min.): 1 × 1 mm

「新たな市場」創造と事業化へのチャレンジ

TSS事業

(トータルソリューションサービス)

当社半導体製造装置のアフターサービスや改修・修理、中古機の販売までトータルで提案



世界のモールドプロセスをTOWAに！！

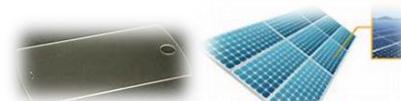
- LEプログラム
(ライフエクステンション)
- 中古機販売
- 予防保全（年間契約）
- 部品供給
- トレーニングセンター

コーティング

TOWAオリジナルの金型表面処理技術を医療や家庭用品等に応用展開



打錠分野への普及率向上



ガラス製品への普及率向上

ナノテク

超精密金型加工で培った超精密・微細加工技術を医療、自動車分野等に応用展開



細胞培養分野における商品開発



HUD(ヘッドアップディスプレイ)用レンズの開発



空中映像素子レンズの開発

ツーリング

金型製造メーカーのノウハウが蓄積された自社開発の工具を販売



CBN・超硬エンドミル



受託加工



3Dプリンタと自社製工具の融合

メディカルデバイス事業

会社名 株式会社バンディック

代表取締役社長 寺内 利浩

事業内容 医療用プラスチック成形品の製造
医療機器の組立

従業員数 95名 (2025年12月末時点)

所在地 山梨県韮崎市龍岡町下條南割596の146

設立 1983年11月18日

主な製品

医療用プラスチック成形品



超精密金型技術と独自技術による
プラスチック成形プロセス



クリーンルーム内で組立、生産

レーザ加工装置事業

会社名 TOWAレーザーフロント株式会社

代表取締役社長 早坂 昇

事業内容 レーザ及びレーザ加工装置の開発・設計・製造・販売・保守

従業員数 106名 (2025年12月末時点)

所在地 神奈川県相模原市中央区下九沢1120番地

株式取得日 2018年8月1日

主な製品

レーザトリマ



ウェハマーカ

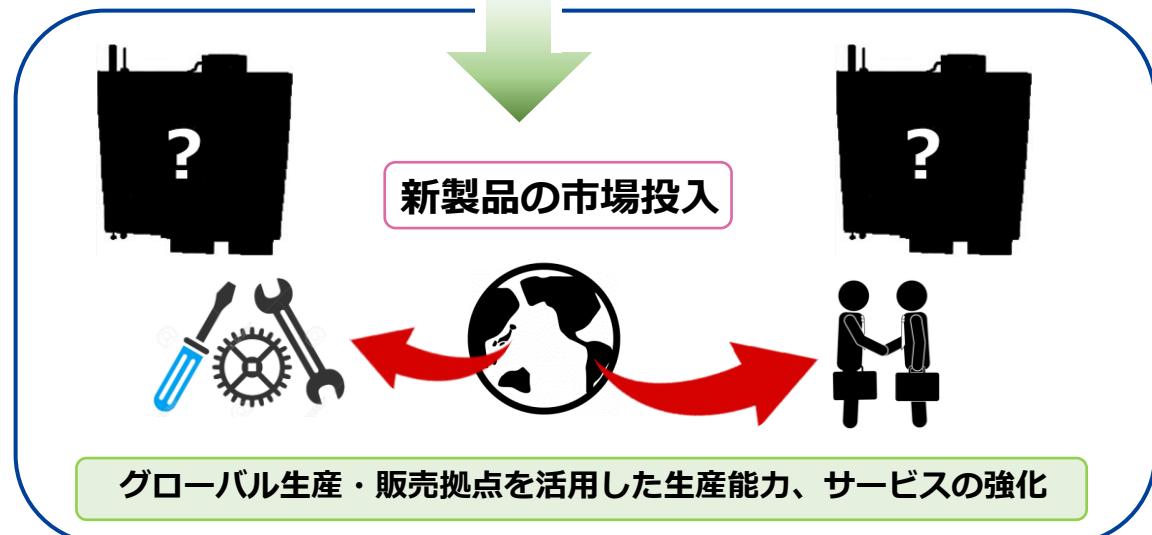


レーザ溶接機



レーザ関連技術と半導体製造の後工程技術を融合し、新たな市場へ

TOWA X **LASERFRONT**



生産拠点

●TOWA

●グループ会社



韓国

●TOWA韓国株式会社

»半導体製造装置、精密金型、部品の製造



●TOWAファイン株式会社

»ブレードの製造



中国

●TOWA半導体設備(蘇州)有限公司

»半導体製造装置、精密金型の製造



●東和半導体設備(南通)有限公司

»半導体製造装置、精密金型の製造



マレーシア

●TOWAM Sdn. Bhd. ●TOWA TOOL Sdn. Bhd.

»半導体製造装置の製造



京都

●本社・工場(京都市)

»半導体製造装置、精密金型の開発・製造



京都

●京都東事業所(宇治田原町)

»半導体製造用金型の製造



佐賀県(鳥栖市)

●九州事業所

»半導体製造用金型の製造



日本

神奈川県(相模原市)

●TOWAレーザーフロント株式会社

»レーザ及びレーザ加工装置の開発、製造

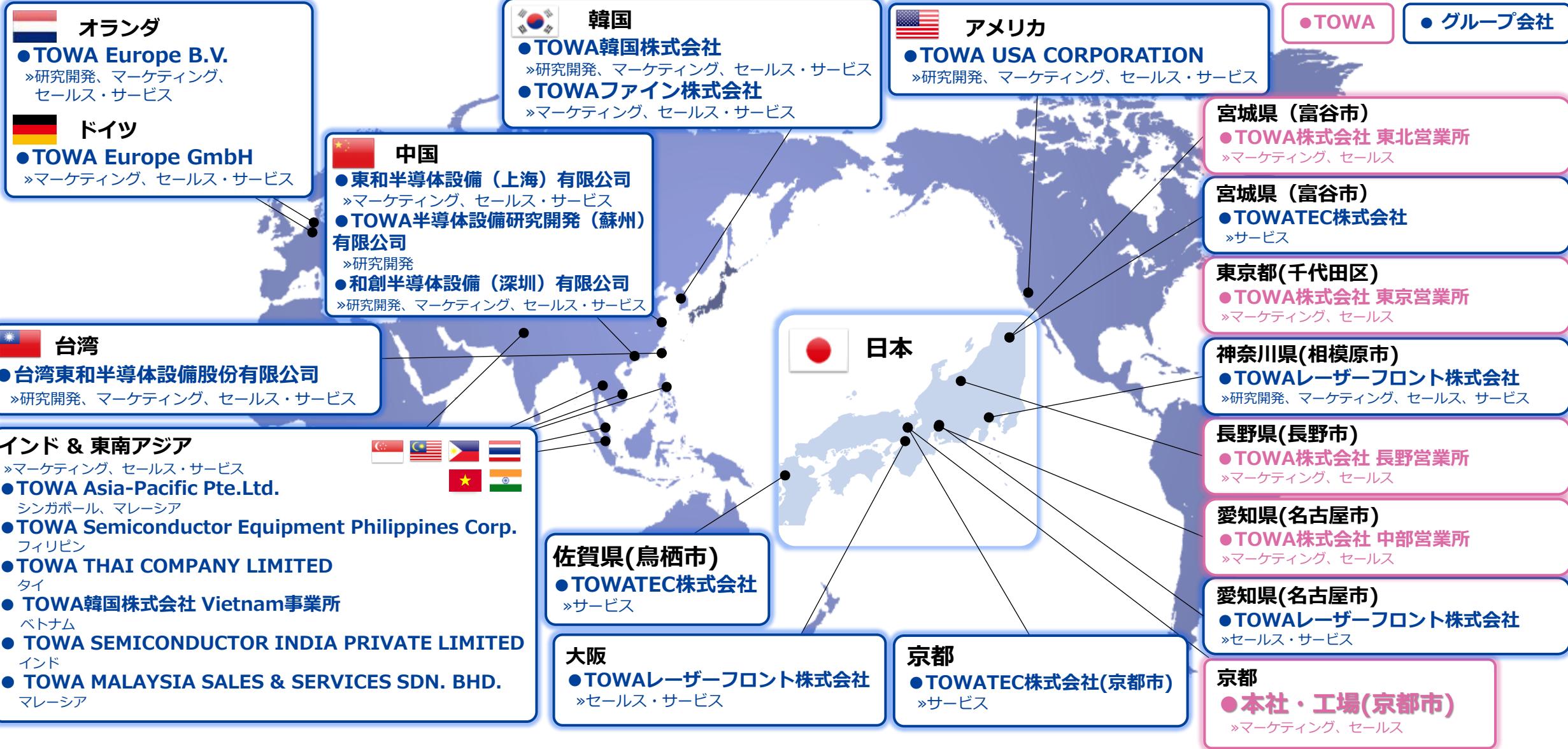
山梨県(韮崎市)

●株式会社バンディック

»ファインプラスチック成形品の製造

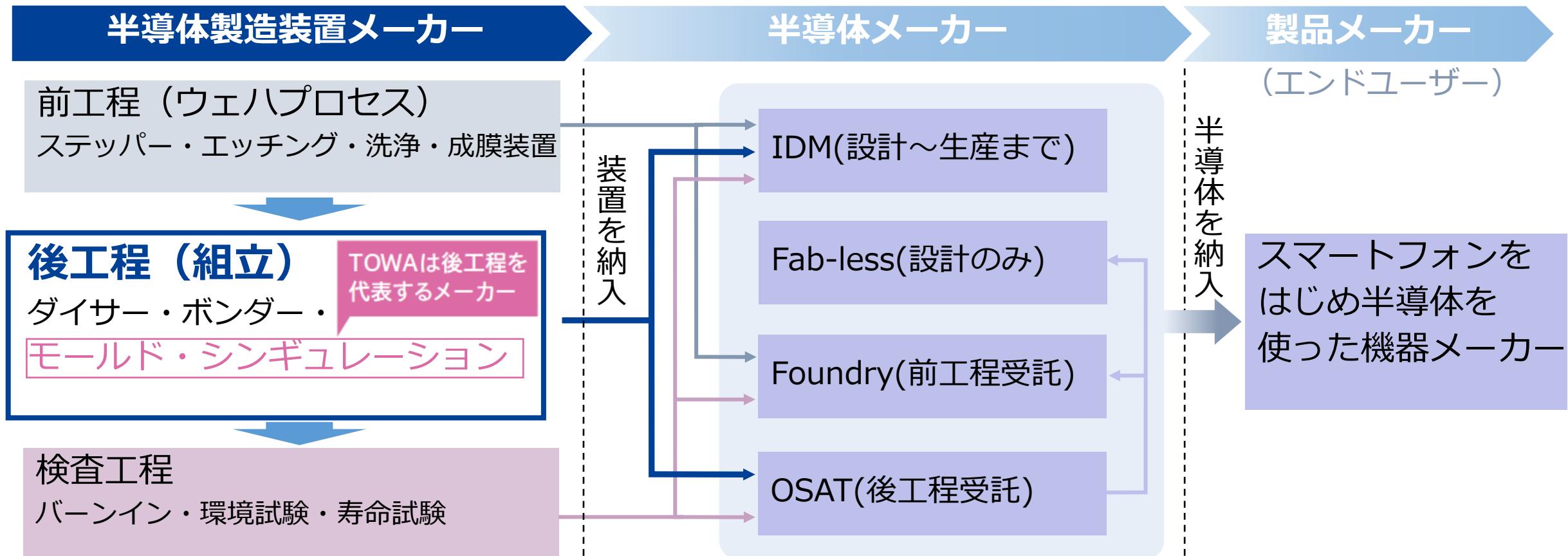


販売・サービス拠点



半導体製造におけるTOWAグループの立ち位置

半導体装置メーカーは、前工程・後工程・検査工程の各専用装置で住み分けされており、装置を半導体メーカーに納入します。半導体メーカーは装置メーカーの装置を使って半導体を製造し、半導体を使った製品をつくるメーカーに納入します。TOWAグループは後工程の半導体装置メーカーに属します。



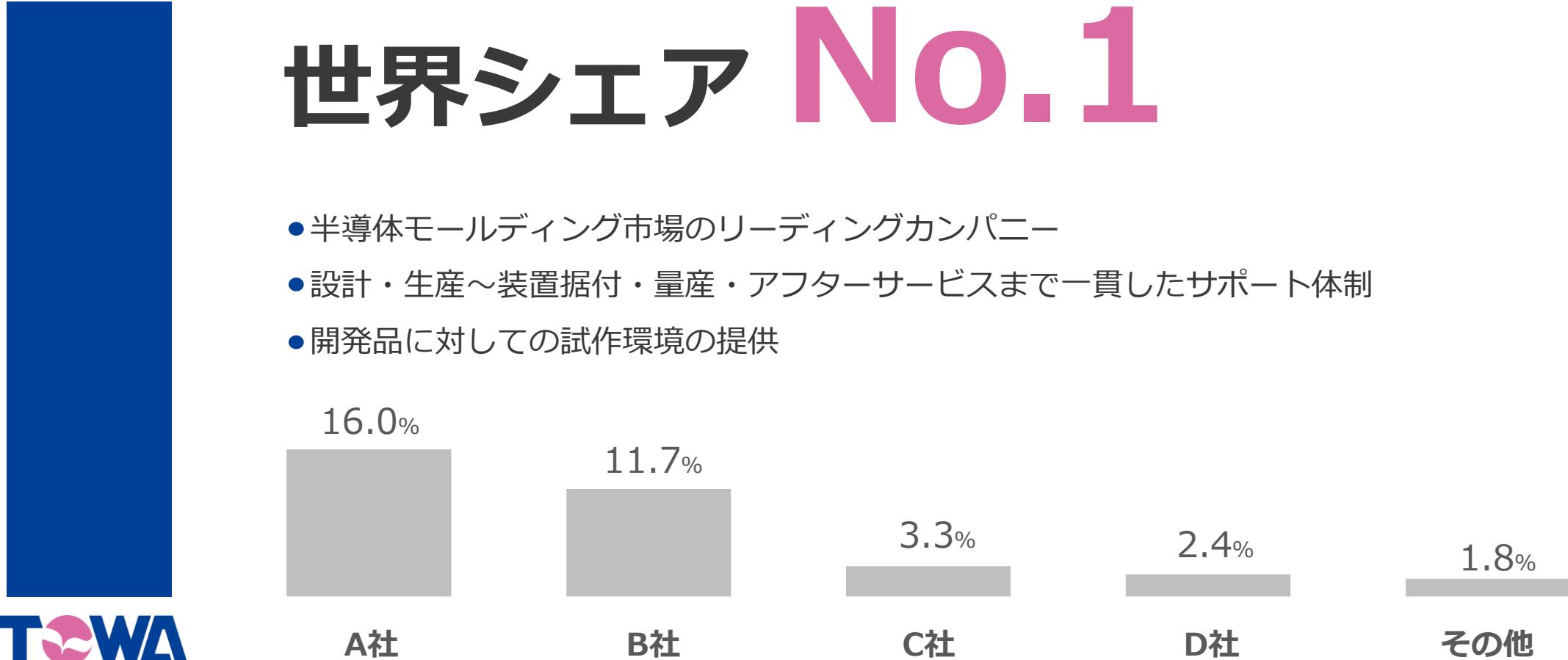
半導体モールディング装置の世界シェア

64.8%

FY2024

世界シェア No.1

- 半導体モールディング市場のリーディングカンパニー
- 設計・生産～装置据付・量産・アフターサービスまで一貫したサポート体制
- 開発品に対しての試作環境の提供



※TechInsights社のデータをもとに当社作成

TOWAの歩み

(億円)



第1次モールディング革命

業界標準の確立

▶マルチプランジャーの開発

第2次モールディング革命

Yシリーズの爆発的ヒット

▶モジュール・システムの開発

医療分野に進出

▶ファインプラスチック成形品

海外生産によるコスト低減

▶海外生産拠点の本格的立上げ

グローバル・サービス体制の確立

▶海外各拠点でフィールドサービスを開始

第3次モールディング革命

新たな業界標準の確立

▶コンプレッション装置の市場投入

ITバブル崩壊

リーマンショック

1979年4月 創業

※ 89/3は決算期変更にともなう3ヵ月決算

1996年9月 大証2部上場

2000年11月 東証1部上場

TOWA10年ビジョン達成

ブレード事業をM&A

▶消耗品ビジネスの本格展開

レーザ加工装置事業をM&A

中国金型事業をM&A

Samsung子会社のモールド事業をM&A

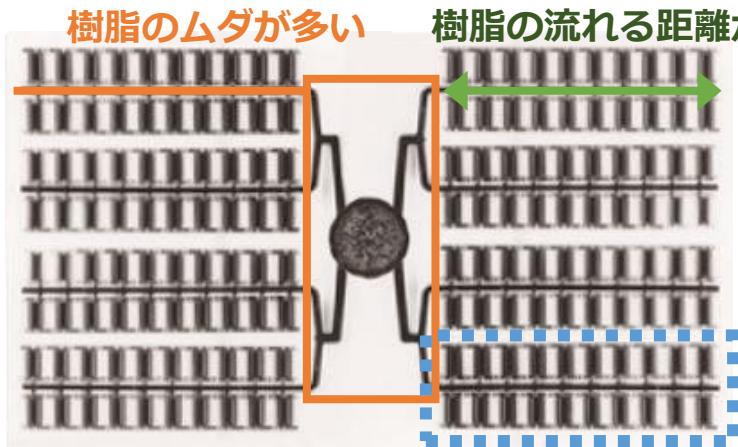
▶Samsung 第1ベンダーの地位を獲得

2022年3月 TOWAビジョン2032発表

第1次モールディング革命(1979年)

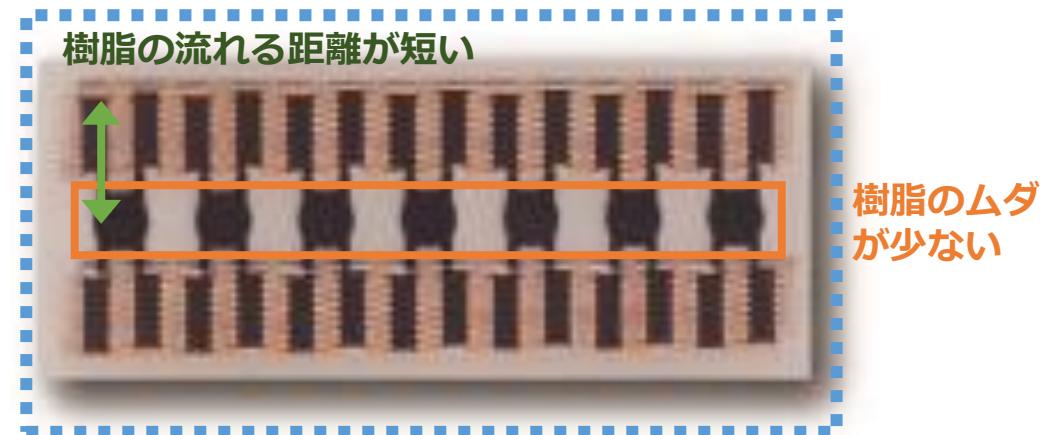
コンベンショナルモールド

手のひらサイズの樹脂を一ヵ所から注入し、手動で成形。樹脂の流れる距離が長く成形品質にバラツキが出来、樹脂のムダが多い。



マルチプランジャモールド

指先サイズの樹脂を複数カ所から注入し、自動で成形。樹脂の流れる距離が短く成形品質が向上し、樹脂のムダが多い。



第2次モールディング革命(1995年)

モジュールシステム (Yシリーズ)

モジュールシステム以前のモールディング装置は・・・

- ・一品一様であり、生産する**製品毎に装置を買い替え**
- ・生産量に応じて**複数の装置を保有する必要がある**



モジュールシステムにより**プレスの増減が可能に!!**

- ・Yシリーズだけで**様々な製品の生産が可能**
- ・生産量に応じて**追加で設備投資が可能**

後工程をIDMから組立専門企業が請け負う時代のニーズに合致!!

世界に誇る半導体モールディング装置のベストセラー



第3次モールディング革命(2009年)

コンプレッション装置

TOWA独自のコンプレッション（圧縮）成形方式により、最先端製品の封止と大幅なコスト削減が可能に!!

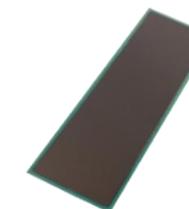
特許や技術的難易度の高さから2009年のリリース以来、今まで他社の追随なし。

特徴

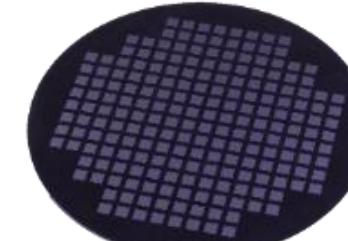
- ・樹脂使用効率100% (CO2排出量約70%削減)
- ・樹脂流動のない圧縮成形(不良品が少ない)
- ・メモリや5G向けなどの最先端製品に最適
- ・顆粒/液状樹脂の両方に対応
- ・パネルサイズ、ウェハーサイズに対応



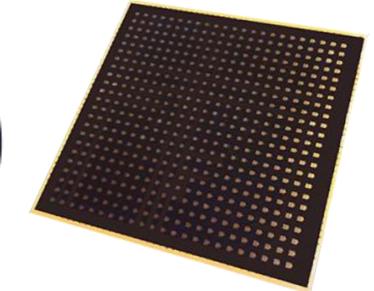
コンプレッション装置
Model PMC2030-D



基板サイズ
100×300mm



ウェハーサイズ
Φ300mm



パネルサイズ
600mm×600mm

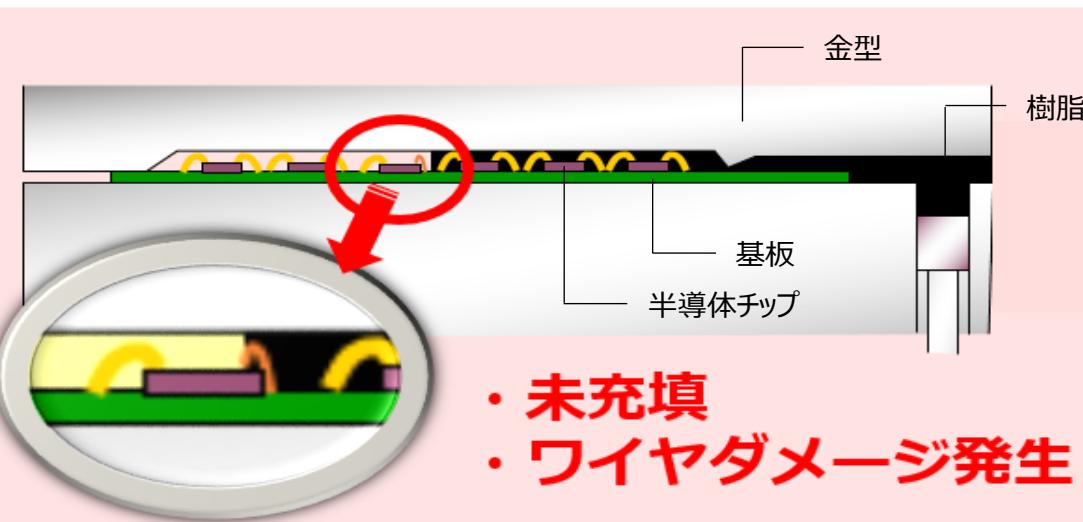
半導体パッケージへのソリューション

トランスファ成形

樹脂流動
有



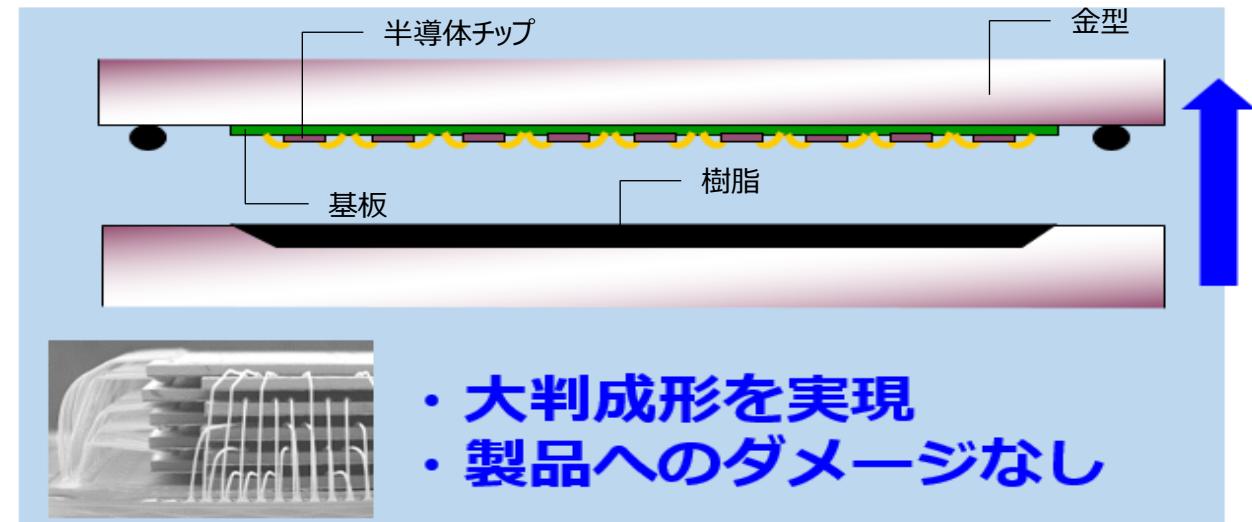
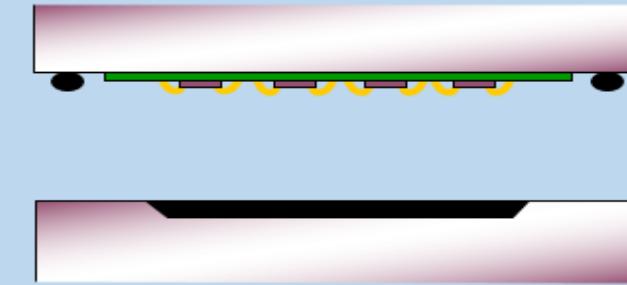
注入
方式



圧縮
方式

コンプレッション成形

樹脂流動
無



半導体製造装置ラインナップ

～Compression Mold～

コンプレッション装置
Model CPM 1180



Work max size: 660 × 620mm

コンプレッション装置
Model CPM 1080



Work max size: φ300mm, 320x320mm

コンプレッション装置
Model PMC 2030-D



Work max size: 100x300mm

～ Transfer Mold～

トランスファ装置
Model YPM 1180



Work max size: 100x300mm

トランスファ装置
Model YPM1250-EPQ



Work max size: □150mm, 100x300mm

～ Singulation～

シンギュレーション装置
Model FMS 4040



Work max size: 100x300mm